

## **REAL3™ Time-of-Flight-Bildsensor der vierten Generation mit HVGA-Auflösung, hochwertigen Fotoeffekten und mehr**

**München – 25. Februar 2019:** Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) präsentiert auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona, Spanien, die vierte Generation seines REAL3™-Bildsensors IRS2771C. Die 3D-Time-of-Flight (ToF)-Single-Chip-Lösung wurde speziell für die Anforderungen des Mobilgerätemarkts entwickelt. Sie soll insbesondere die Nachfrage nach höheren Auflösungen mit kleinen Linsen decken. Die ToF-Lösung eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie die sichere Benutzerauthentifizierung mittels Gesichts- oder Handerkennung zur Entsperrung von Geräten und zur Bestätigung von Zahlungen. Mit dem 3D-ToF-Chip lassen sich außerdem Augmented-Reality-, Morphing- und Fotoeffekte (wie Bokeh) optimieren und Räume scannen.

Der gerade einmal 4,6 x 5 mm große Bildsensor kommt auf 150.000 (448 x 336) Pixel, was fast der HVGA-Standardauflösung entspricht. Damit ist die Auflösung viermal so hoch wie die der meisten heute erhältlichen ToF-Lösungen. Das leistungsstarke Pixelarray ist auf Infrarotlicht mit einer Wellenlänge von 940 Nanometern abgestimmt und bietet eine herausragende Outdoor-Performance. Ermöglicht wird dies durch die patentierte SBI-Schaltung in jedem einzelnen Pixel (SBI = Suppression of Background Illumination bzw. Unterdrückung des Umgebungslichts). Aufgrund des hohen Integrationsgrads gleicht jeder IRS2771C-Bildsensor im Grunde einer Single-Chip-ToF-Kamera im Miniaturformat. Somit werden sowohl Stückliste als auch die tatsächliche Größe des Kameramoduls deutlich reduziert – bei minimalem Stromverbrauch und ohne Abstriche bei der Performance.

### **Beispiellose Robustheit und Energieeffizienz**

„Die Robustheit dieses Bildsensors gegenüber Umgebungslicht sowie seine Energieeffizienz sind beispiellos auf dem Markt“, sagte Philipp von Schierstaedt, Vice President und verantwortlich für den Bereich RF & Sensors von Infineon. „Mit der neuen Generation von Bildsensoren kann Infineon seine führende Position weiter

ausbauen. Jeder Elektronik-Hersteller kann mit dem neuen REAL3-Chip den Wert seiner Produkte steigern, und zudem das Design individualisieren sowie die Time-to-Market verkürzen.“

Durch seine langjährige Partnerschaft mit pmdtechnologies hat sich Infineon umfassendes Know-how rund um Algorithmen für verarbeitete 3D-Punktwolken (ein Satz von Datenpunkten im Raum, der durch 3D-Scannen erzeugt wird) angeeignet. Neben Hardware-Expertise bietet Infineon seinen Kunden auch ein umfangreiches Tool- und Software-Angebot. „Die erfolgreiche Zusammenarbeit hat gezeigt: Erstklassige 3D-ToF-Systeme lassen sich nur realisieren, wenn sie allumfassend und von Grund auf konzipiert werden – vom hochmodernen ToF-Pixel-, Imager- und Moduldesign bis hin zur fortschrittlichen Signalverarbeitung“, sagte Bernd Buxbaum, CEO von pmdtechnologies. „Unsere Kunden profitieren dabei von der enormen Erfahrung der pmd aus 15 Jahren Entwicklung und Herstellung von erstklassigen 3D-ToF-Produkten.“

### **Verfügbarkeit**

Der neue 3D-Bildsensorchip wurde in Graz, Dresden und Siegen entwickelt und vereint das Know-how der deutschen und österreichischen Standorte von Infineon in einer einzigen Lösung. Muster sind ab März verfügbar, die Serienfertigung ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Weitere Informationen zur 3D-Bildsensor-Familie von Infineon sowie das Angebot auf dem Mobile World Congress 2019 sind verfügbar unter [www.infineon.com/real3](http://www.infineon.com/real3) und [www.infineon.com/MWC](http://www.infineon.com/MWC).

### **Über Infineon**

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt

unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Information über REAL3™ sind unter [www.infineon.com/real3](http://www.infineon.com/real3) verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist online unter [www.infineon.com/presse](http://www.infineon.com/presse) verfügbar.

Folgen Sie uns: [Twitter](#) - [Facebook](#) - [LinkedIn](#)

### **Über die pmdtechnologies ag**

Die pmdtechnologies ag, ein fabless IC-Unternehmen mit Sitz in Siegen (Deutschland), San Jose (USA), Seoul (Korea) und Shanghai (China), ist der weltweit führende Anbieter für CMOS-basierte, digitale 3D Time-of-Flight Bildsensor Technologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und besitzt über 350 Patente weltweit, die sich mit pmd-basierten Anwendungen, dem pmd-Messprinzip und dessen Umsetzung befassen. 3D-Sensoren von pmd bedienen die Zielmärkte industrielle Automatisierung, Automotive und das breit gefächerte Feld der Consumer Anwendungen wie z.B. in Smartphones. Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter [pmdtec.com](http://pmdtec.com).

### **pmdtechnologies ag | contact**

Sabrina Buxbaum  
Director Corporate Strategy & Marketing  
Phone: +49 271 23 85 38 800  
E-Mail: [s.buxbaum@pmdtec.com](mailto:s.buxbaum@pmdtec.com)

### **Infineon Technologies AG | contact**

Gregor Rodehueser  
Press Spokesperson  
Markets & Business Development  
Phone: +49 89 234 28 481  
E-Mail: [gregor.rodehueser@infineon.com](mailto:gregor.rodehueser@infineon.com)